



#### RE3025-LF

- Lámina estratificada de tejido de fibra de vidrio con resina epoxi FR4 de 1,50 mm
- Por una cara 35 µm de Cu (cobre)
- Estañado en caliente (HAL-leadfree [nivelación con aire caliente – sin plomo])
- Máscara de soldadura
- Una conexión de 40 pines para Raspberry Pi
- 21 x 32 orificios de 1,00 mm de Ø
- Campo de experimentación en cuadrícula de 2,54 mm con 13 x 28 almohadillas de soldadura de 2,20 mm de Ø
- Dos pistas potenciales
- Cuatro orificios de captura de 2,75 mm de Ø
- 85,00 x 56,00 mm